**欢迎订阅2025年《覆铜板资讯》**

**欢迎在2025年《覆铜板资讯》上刊登宣传资料**

**《覆铜板资讯》**是由中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）主办的双月刊杂志，是全球唯一的针对覆铜板及相关产业的专业性杂志，是《维普资讯-中文期刊服务平台》收录期刊。主要内容有覆铜板、印制板技术，原材料、设备技术，测试技术，行业动态，市场调查分析，企业管理等与覆铜板相关的各种资讯。是覆铜板及上、下游行业技术、管理、经营各种信息交流的重要平台。在业界获得普遍好评。

本刊从2024年11月起，开始2025年度杂志订阅和刊登宣传资料的征订工作，有关事项如下。

《覆铜板资讯》每期单价30元，全年6期订价180元。

**凡2025年度在《覆铜板资讯》上刊登宣传资料全年者，其资料同时免费同步在《中国覆铜板信息网》（ www.chinaccl.cn ）上发布，全年刊登者，网上发布 1 年。**

**在《覆铜板资讯》上刊登宣传资料的赞助费用标准为：封面每期5000元（每期赠阅5册），封二、彩色扉页、封底每期3500元（每期赠阅4册），彩色插页2500元/期·页（每期赠阅3册），封三每期2000元（每期赠阅2册），黑白插页800元/期/版（每期赠阅1册）。**

请您详细填写下列内容，用传真或电子邮件发回编辑部。

1、您决定订阅2025年《覆铜板资讯》全年 套，共计 元，计划 月 日汇出。

2、您决定在2025年《覆铜板资讯》的第 期至第 期在 位置刊登宣传资料，宣传赞助费用共 元，计划于 月 日汇出。

3、您的公司资料：公司名称 负 责 人

公司详细地址 邮 编

主要产品

4、您的个人资料：姓 名 性 别 职 位 部 门

联系电话 E-mail

5、您的主要职责：□设计/开发 □采购 □工艺技术品质管理 □市场及销售 □学术研究

□总/副总经理/厂长 □其他（请说明）

汇款及联络事项：

|  |
| --- |
| **银行汇款事项：帐 户:中国电子材料行业协会**  **开户银行:工行北京香河园支行**  **账 号: 0200 0191 0900 0125 724**  **联 系 人： 王晓艳 电话： 029-33335234 15667246308（微信同号）邮箱：ccla33335234@163.com** |

欢迎订阅覆铜板行业协会现存书籍资料

请您详细填写订阅单，传真或E-mail发回秘书处，款到即寄书。（注意：在订购序号7-20、21-26、27-42、43-51书籍时，请在订阅数栏目中注明所选书目序号）

**订 阅 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订阅单位 | |  | | | | | | |
| 详细地址 | |  | | | | | 邮编 |  |
| 联 系 人 | |  | 部门 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 序号 | 资料名称 | | | | | 单价（含邮费） | 订阅数 | 金额 |
| 1 | 《覆铜板资讯》杂志1-6期 | | | | | 180元/年、6期 |  |  |
| 2 | 印制电路用覆铜箔层压板（辜信实主编）（工艺、测试技术）第2版 | | | | | 160元/册 |  |  |
| 3 | 覆铜箔层压板技术文集（专家文集二）祝大同著 | | | | | 100元/册 |  |  |
| 4 | 覆铜箔层压板技术文集（专家文集三）张洪文著 | | | | | 100元/册 |  |  |
| 5 | 刚性及多层印制板用基材规范及试验方法汇编（2002年版） | | | | | 100元/册 |  |  |
| 6 | 覆铜板手册（2007年版） | | | | | 100元/册 |  |  |
| 7-20 | 2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018、2019、2020年、2021年、2022年、2023、2024年行业高层论坛文集 | | | | | 100元/册  或光盘/U盘 |  |  |
| 21-26 | 覆铜箔板新技术、新产品文集（一）（二）（三）（四）（五）（六） | | | | | 150元/册 |  |  |
| 27-42 | 第一至十六届中国覆铜板技术·市场研讨会报告·论文集 | | | | | 150元/册 |  |  |
| 43-51 | 第十七届、十八届、十九届、二十届、二十一届、二十二届、二十三届、二十四届、二十五届中国覆铜板技术研讨会报告集 | | | | | 200元/U盘 |  |  |
| 合计金额（大写） | | | | | | —— |  |  |

1、《覆铜板资讯》杂志 覆铜板行业协会主办，1997年创刊，双月刊。中国知识资源总库 中国期刊全文数据库收录期刊。近年在覆铜板及上下游行业获得普遍好评。

2、《印制电路用覆铜箔层压板》中外首部系统阐述种种覆铜板制造技术、工艺、测试等的正式出版专著。

3、《覆铜箔层压板技术文集(专家文集二)》 共收录业内资深专家祝大同高工个人献文32篇。

4、《覆铜箔层压板技术文集（专家文集三）》 共收录业内资深专家高工张洪文个人文献40篇。

5、《刚性及多层印制板用基材规范及试验方法汇编》 IPC4101A及TM-650、J-STD-003、UL94中CCL试验方法汇编。

6、《覆铜板手册》覆铜板及原材料、设备厂商（共544家）有关资料及覆铜板常见问题解答、“十一五覆铜板发展建议书等资料。2007年版。

7、《覆铜板新技术、新产品文集》（一）-(六)分别汇集了《覆铜板资讯》总第1-8期、9-14期、15-22期、23-33期、34-42期、43-51期的技术文献。

8、第一至二十五届中国覆铜板技术研讨会文集资料 汇编了2000年～2024年召开的历届研讨会文献。

汇款及联络事项：

|  |
| --- |
| **银行汇款事项：帐 户:中国电子材料行业协会**  **开户银行:工行北京香河园支行**  **账 号: 0200 0191 0900 0125 724**  **联 系 人： 王晓艳 电话： 029-33335234 15667246308（微信同号）邮箱：ccla33335234@163.com** |